

## NEU Lehmputz HW

### WAS IST NEU?

- Korngröße zwischen Fein- und Grobputz
- Geringes Gewicht durch Leichtzuschläge
- Poröse Gesteinszuschläge
- Feinfaserzugabe



CLAYTEC Lehmputz HW wurde für den Verputz von magnesitgebundenen Holzwolleplatten und mitteldicken Wandflächenheizsystemen entwickelt. Er ist der Lehmörtel für den modernen ebenen Untergrund. Durch seine besondere Kornzusammensetzung liegt sein Anwendungsbereich bei Auftragsdicken zwischen 3 und 10 mm. Die Wasseraufnahmefähigkeit der Zuschläge aus porösem Gestein lässt ihn schnell anziehen und sorgt für frühe Festigkeit. Das macht Lehmputz HW besonders geeignet für schwach saugende Untergründe. Die Feinfaserzugabe macht ihn sehr pastös, CLAYTEC Lehmputz HW ist bestens verarbeitbar.

### BESTE WERTE NACH DIN 18947

- Festigkeitsklasse S II
- Wasserdampfsorptionsklasse WS III
- Baustoffklasse A1 nicht brennbar



**NEU** jetzt im preisgünstigen 800 kg-Großgebinde!



Art.-Nr. 10.810  
25 kg-Sack (48 Sack/Palette)  
5,7 m<sup>2</sup> bei D= 3 mm  
1,7 m<sup>2</sup> bei D= 10 mm



Art.-Nr. 05.810  
800 kg-Big-Bag  
182 m<sup>2</sup> bei D= 3 mm  
54,4 m<sup>2</sup> bei D= 10 mm



Lehmputz HW kann naturfarbig belassen oder mit CLAYFIX Lehm direkt gestrichen werden.

Er ist ein sehr guter Untergrund für YOSIMA Lehm-Designputz.

### VORTEILE:

- **Bessere Verarbeitbarkeit**
- **Schnelles Anziehen**
- **Lehmputz speziell für mitteldicke Aufträge**

Technische Beratung: +49 2153 918-24

Servicenummer: +49 800 2529832

Produktdaten und Anwendung siehe Rückseite →



## Nach DIN:

Lehmputz HW, Art.-Nr. 05.810, 10.810

Lehmputzmörtel - DIN 18947 - LPM 0/2 f – S II – 1,6



geeignet für WAKA  
Flächen-Heiz & Kühlsysteme

<b>Lehmputzmörtelart</b>	Lehmputzmörtel als Lehmwerkmörtel. Trocken.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Mitteldicker einlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich. Besonders geeignet für ausreichend griffige, aber nur schwach saugende Untergünde wie Beton, hochdämmende Mauerziegel, magnetisgebundene Holzwoleplatten (z.B. WAKA Flächen- Heiz- & Kühlsysteme), Foamglas-Dämmplatten und anderen ausreichend ebenen Flächen aus geeigneten Baustoffen. Hand- oder Maschinenputz.
<b>Zusammensetzung</b>	Natur-Baulehm, gemischtkörniger gewaschener Sand 0 - 1,0 mm, Naturbims 0 - 1,5 mm. Korngruppe, Überkorngröße nach DIN 0/2, bis 3 mm. Naturfasern.
<b>Herkunftsland</b>	Deutschland
<b>Baustoffwerte</b>	Trocknungsschwindmaß < 2,0 %. Festigkeitsklasse S II. Biegezugfestigkeit 0,8 N/mm <sup>2</sup> . Druckfestigkeit 2,5 N/mm <sup>2</sup> . Haftfestigkeit 0,12 N/mm <sup>2</sup> . Abrieb 0,3 g. Rohdichteklasse 1,6. Wärmeleitfähigkeit 0,73 W/m·K. µ-Wert 5/10. Wasserdampfadsorptionsklasse WS III. Baustoffklasse A1.
<b>Lieferform, Ergiebigkeit</b>	05.810: 800 kg-Big-Bag (erg. 544 l Putzmörtel für 91 m <sup>2</sup> D= 6 mm) 10.810: 25 kg Sack (erg. 17 l Mörtel für 2,8 m <sup>2</sup> D= 6 mm), 48 Sack/Pal.
<b>Lagerung</b>	Trockene Lagerung unbegrenzt möglich.
<b>Mörtelbereitung</b>	Unter Zugabe von ca. 30 % Wasser (7,0 l pro 25 kg Sack) mit dem Motorquirl oder von Hand. In großen Mengen auch mit allen handelsüblichen Freifall-, Teller- und Trogzwangsmischern. Hinweise zum Putzmaschineneinsatz unter <a href="http://www.claytec.de">www.claytec.de</a> . Wird der Mörtel nicht umgehend verarbeitet muss aufgrund des Saugvermögens der Zuschläge ggf. erneut Wasser zugegeben werden (nach 30 Minuten ca. 1,5 l). Lässt man den Mörtel vor der Verarbeitung längere Zeit einsumpfen ggf. weiteres Wasser zugeben und nochmals gut durcharbeiten.
<b>Putzgrund</b>	Der Putzgrund muss tragfähig, frostfrei, trocken, sauber, frei von Salzbelastung sein. Schwach saugfähige Untergründe müssen ausreichend rau und griffig sein. Als Grundierung ist bei Bedarf DIE GELBE Grundierung (CLAYTEC 13.420-.345) geeignet.
<b>Putzauftrag, Oberfläche</b>	Der Mörtel wird mit der Kelle aufgezogen oder mit der Putzmaschine angespritzt. Minimale und maximale Auftragsdicke 3 und 10 mm, auf WAKA Flächen- Heiz- & Kühlsystemen 8 mm. Auf Holzwoleplatten und WAKA Flächen wird Bewehrungsgewebe (CLAYTEC 35.001, 35.010 oder 35.030) auf den noch nassen Putz aufgelegt und eingearbeitet. Auf homogenen Massivbau-Untergründen ist die Einarbeitung eines Bewehrungsgewebes systemisch nicht notwendig. Lehmputz HW zieht wegen der Saugfähigkeit seiner Zuschlagstoffe schnell an und kann schon nach kurzer Zeit bearbeitet werden. Die Oberflächenstruktur ist abhängig vom Zeitpunkt der Bearbeitung und vom verwendeten Werkzeug. Grundsätzlich ist die Struktur um so feiner, je mehr der Putzmörtel zum Zeitpunkt der Oberflächenbearbeitung angezogen hat. Geriebene Oberflächen werden mit Schwamm-, Kunststoff- oder Holzreibebrettern hergestellt. Glatte Oberflächen werden durch die Nachbehandlung mit dem Glätter erreicht.
<b>Verarbeitungsdauer</b>	Da kein chemischer Abbindeprozess stattfindet, ist das Material abgedeckt über mehrere Tage verarbeitungsfähig, erneute Wasserzugabe s.o. Bei Ruhezeiten in Putzmaschinen und Schläuchen muss ggf. das Stocken des Materials berücksichtigt werden. Anders als bei anderen Lehmputzen kann es notwendig werden, die Geräte bei längeren Unterbrechungen zu leeren und zu reinigen.
<b>Weiterbehandlung</b>	Der Anstrich ist mit DIE WEISSE Grundierung (CLAYTEC 13.415-.010) und CLAYFIX <i>Lehm direkt</i> Streichputz oder Lehmfarbe möglich. Auch viele andere Anstrichsysteme sind geeignet. Lehmputz HW ist ein sehr guter Untergrund für YOSIMA Lehm-Designputz.
<b>Arbeitsproben</b>	<b>Untergrundeignung, Auftragsstärke und Oberflächenwirkung sind in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen. Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind ausgeschlossen.</b> <b>CLAYTEC Arbeitsblatt 6.1 ist unbedingt zu beachten, verfügbar auf <a href="http://www.claytec.de">www.claytec.de</a>.</b>

© CLAYTEC e. K. · 41751 Viersen · Ausgabe 1-2016 · gültig 12 Monate, danach siehe [www.claytec.com](http://www.claytec.com)